



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ и рекомендации по обработке

Сухой пленочный фоторезист FD-1730B

компании First (Hangzhou First Electronic Materials Co., Ltd /
Hangzhou Foster Applied Materials Co., Ltd).

Производство - Китай.

FD-1730B – это высококачественный сухой пленочный фоторезист водощелочного проявления прямого лазерного экспонирования (без фотошаблона), применяемый при изготовлении печатных плат.

Фоторезист FD-1730B совместим с процессами гальванического меднения, оловянирования, золочения, никелирования; нанесения покрытий: золото, медь, олово, никель.

Применение: кислотное травление внутренних и наружных слоев.

Высокое разрешение, высокая адгезия и быстрое удаление пленки помогают предприятиям повысить выход продукта и увеличить производственные мощности.

Характеристика продукта.

- Сухой негативный пленочный фоторезист.
- Предназначен для получения тонких линий изображения.
- Неэкспонированный цвет при желтом свете: **сине-зеленый**
- Проявленное изображение: **четкое**

Преимущества фоторезиста FD-1730B:

- * Отличная адгезия.
- * Высокое разрешение.
- * Быстрое удаление и проявление фоторезиста.
- * Широкий диапазон технологических параметров.
- * Отличная перекрываемость отверстий
- * Яркий цвет, чёткость изображения до и после экспонирования.
- * Быстрое удаление пленки и увеличение производственных мощностей.

Размеры фоторезиста:

- Толщина фотослоя: 30 мкм,
- Ширина рулона: 200 - 650 мм.
- Минимальный заказ — 1 коробка (2 рулона).

Результаты испытаний.

FD-1730B		
		Установка LDI**
Энергия засветки под шаблоном, мДж/см²		12 (9-16)
Концентрация раствора проявления Na₂ CO₃, %		0,9-1,1
Температура проявления		30±2
Минимальное время проявления, с		13
Концентрация раствора снятия, NaOH, %		3,0±1,0
Температура снятия, °C		50±5
Минимальное время снятия, с		30
Размер частиц (мм)		<30
Разрешение, мкм	17/41 ST	27,5
	20//41 ST	25
	23/41 ST	25
Адгезия, мкм	17/41 ST	30
	20//41 ST	27,5
	23/41 ST	25

Примечание: Экспонирующее оборудование: CDI-1XS-FL, экспонирующая линейка для проверки чувствительности: Stouffer 41ST.

Данные лабораторных испытаний только для справки!

Производить подбор режимов с учетом производственного оборудования.

Подготовка поверхности заготовок.

Для улучшения адгезии фотополимера к медной поверхности рекомендуется произвести тщательную подготовку поверхности.

Существует несколько методов подготовки поверхности:

- Механический (пенза или щетками на установке).
- Химический (кислотный очиститель).
- Микротравление (предпочтительнее).

Операции очистки микротравлением.

- Кислотная ванна очистки: >35°C - 2-3 мин.
 - Струйная промывка: 1-2 мин.
 - Микротравление: для получения шероховатости 0,15-0,26 мкм меди
- Состав для микротравления: персульфат натрия и 1% H₂SO₄ при T= 20-25°C.
- Струйная промывка: 1-2 мин.
 - Подтравливание в сернокислотной ванне (5-10%): 1-2 мин.
 - Струйная промывка 1-2 мин.

Промывка

- Двуступенчатая, проточная вода.
- Температура промывки: 20-25° C.
- Время промывки ≥1 мин.

Значения режимов подготовки поверхности, приводимые в данной рекомендации, получены на определенном производственном оборудовании и предлагаются лишь в качестве ориентировочных значений для производственного процесса. Реальные параметры технологии обработки будут зависеть от применяемого оборудования и их необходимо определять для каждого конкретного производства.

Ламирование.

Перед нанесением фоторезиста заготовки необходимо предварительно нагреть в сушильном шкафу, температура 40-60 °C.

Время предварительного нагрева подложки не должно быть слишком большим, а температура слишком высокой, иначе это может привести к окислению фотослоя.

Режимы ламирования:

- Температура валков: 100-120 °C.
- Давление: 3-6 кг/см².
- Скорость: 1,0-3,0 м/мин.

Время и условия хранения после ламирования.

- Экспонирование можно проводить сразу же после ламирования, но лучше выдержать заготовки при комнатной температуре не менее 15 минут.

- Максимальная продолжительность хранения заготовок после нанесения фоторезиста до экспонирования (рекомендации): до 3 дней.
- Предпочтительно: в вертикальных кассетах, нежелательна горизонтальная укладка заготовок.

Экспонирование.

Воспроизведение линий будет зависеть от того, на каком оборудовании проводится экспонирование и определяется для каждой конкретной установки.

Источником воздействия является лазерный источник света.

Подходит для источников света 355 и 405 нм.

Рекомендуемые режимы экспозиции: 17,0-20,0 ST (41).

Проявление.

- Карбонат натрия, безводный (кальцинированная сода) Na_2CO_3 .

Рабочий раствор: 0,9 - 1,1 %.

Концентрация Na_2CO_3 : 8,0 – 12,0 г/л.*

- Карбонат натрия $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$.

Рабочий раствор: 1,0 – 1,1 %.

- Температура: $30 \pm 2^\circ\text{C}$.
- Давление распыления: 0,12-0,2 МПа

Пеногасители.

FD-1730B может обходиться и без применения пеногасителей. Потребность в пеногасителях зависит от качества воды, чистоты реагентов, загрязнения раствора фоторезистом, конструкции оборудования и конкретных условий производства. Предварительно их нужно проверить на совместимость с материалом. При циклическом технологическом режиме добавлять пеногаситель при составлении ванны.

При наличии автоматической системы проявления добавлять пеногаситель непосредственно в ванну в зону высокой турбулентности. Не добавлять пеногаситель в расходный бак или в корректирующий раствор!

Режимы промывки и сушки.

- Промывочная вода.

Предпочтительнее использовать жесткую воду (150-250 мг-экв/л CaCO_3).

- Температура промывки: 15-25° С

- Давление воды: 0,1-0,12 МП.
- Сушка: тщательная обдувка воздухом. Предпочтительно горячим.
- Слить отработанный проявитель, когда показатель pH достигнет значения 10,2.

Время хранения после проявления до металлизации:

Рекомендуется: 0 - 3 дня.

Примечание: Во избежание развития хрупкости пленки рекомендуется свести к минимуму засветку проявленного фоторезиста белым светом.

Уход за проявителем.

Рекомендуется 1 раз в неделю очищать проявитель от осадка фоторезиста, углекислого кальция, пеногасителя

Очистка оборудования.

Залить в ванну 5% раствор КОН или NaOH. Нагреть до температуры 55°C, включить установку на 30 - 90 мин., чтобы растворить частицы фоторезиста. Затем слить раствор и промыть установку чистой водой в течение 30 мин.

При необходимости повторить очистку оборудования от осадка.

Остатки сине-зеленого красителя на оборудовании рекомендуется удалять в 5%-ном растворе HCl при температуре 55°C в течение 30 мин.

Удаление фоторезиста.

Раствор для удаления фоторезиста:

- Температура – 50±5 °C.
- Концентрация NaOH 2,5-5,0 %.
- Давление: 0,12 Мпа

При концентрация сухой пленки более 0,52 м² /л рекомендуется заменить раствор.

Руководство по процессу обработки.

(чистая комната; температура - 20-22°C; относительная влажность - 50±10%)

Процесс		Рекомендации	
Нанесение	Температура валка, °C	110 ± 10	Температура на выходе 50±10°C
	Скорость, м/мин.	2,0 ± 1,0	
	Давление валка, кг/см ²	3 - 6	
Время выдержки	Время, мин.	15 мин. - 8 часов	В жёлтой свете
Экспонирование	Энергия, мДж/см ²	12 (9-16)	Без шаблона
Время выдержки	Время, мин.	15 мин. - 24 часа	В жёлтой свете
Проявление	Химическое Na ₂ CO ₃ , %	1,0±0,1	
	Температура, °C	30±2	
	Точка проявления, %	45 - 55	
	Давление распыления, кг/см ²	2,0 ± 0,5	
	Минимальное время проявления, мин.	13	
Снятие	Химическое NaOH, %	3,0±0,5	
	Температура, °C	49-51	
	Минимальное время удаления, мин	30	

Условия хранения:

Фоторезист **FD1730B** следует хранить в нераскрытой оригинальной упаковке на стеллажах в вентилируемом помещении при условиях:

Температура (T): 5 – 20 °C.

Относительная влажность (RH): не менее 60 %.

Стеллажи должны находиться на расстоянии не менее метра от отопительных приборов и не менее 0,1 метра от пола. В помещение, где хранится фотоматериал, не должны проникать вредные газы, сероводород, ацетилен, аммиак, окислы азота, пары ртути и т.п.

Срок годности **FD1730B** при соблюдении этих условий составляет: **60 дней** (с даты изготовления).

Перед использованием фоторезист должен пройти акклиматизацию на производственном участке при температуре $21\pm3^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $50\pm10\%$.

Меры предосторожности.

Поскольку сухая пленка содержит мономеры акрилата, она может раздражать кожу и вызывать кожную аллергию.

Это требует применения защитных мер:

- Не контактировать непосредственно с сухим пленочным фотослоем, надевать защитные перчатки перед работой.
- Если фоторезист попадет в глаза, немедленно промыть их водой и обратиться к врачу для обследования.

Поскольку проявитель и раствор удаления фоторезиста являются щелочными растворами, а травильный раствор-кислым, прямой контакт с ними невозможен, поэтому при ремонте и эксплуатации оборудования необходимо принимать защитные меры и надевать защитные очки и перчатки. Сухой пленочный продукт сине-зеленого цвета. При длительном времени хранения цвет сухой пленки может частично выцвести, но это не влияет на его использование.